

CORFIL® 625-1

Adhesive

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CORFIL® 625-1 potting compound is a one-part, low density material formulated for use in insert and edge filling of honeycomb core. It may also be used as a syntactic core splice adhesive. It is formulated to have low viscosity making it especially suitable for use with automated equipment. CORFIL 625-1 can be cured at either 250°F (121°C) or 350°F (177°C) with minimal to no exotherm in large applications.

FEATURES & BENEFITS

One-part pumpable material

250°F (121°C)/ 350°F (177°C) cure

Minimal exotherm

-67 to 350°F (-55 to 177°C) service range

| Главная Информация | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Характеристики | Низкая вязкость Тиксотропный | |
| Используется | Клеи Заполнение приложений Детали конструкции | |
| Внешний вид | Белый | |
| Формы | Паста | |
| Метод обработки | Полировка | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Прочность на сжатие (24°C) | 20.7 to 21.4 | МПа |
| Прочность сдвига ¹ (24°C) | 6.89 to 8.27 | МПа |
| NOTE | | |
| 1. | Filled Tube | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

